

## 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人  
岩見 知典

様

あて名

〒 520-8558  
滋賀県大津市園山1丁目1番1号  
東レ株式会社知的財産部内PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
(PCT規則43の2.1)発送日  
(日.月.年) 09.3.2004出願人又は代理人  
の書類記号 TP-03068-PCT 今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号 PCT/JP2004/000475 国際出願日 (日.月.年) 21.01.2004 優先日 (日.月.年) 23.01.2003

国際特許分類 (IPC)  
Int. C17 H05K3/00, H05K1/02, B65H29/64, B65H41/00出願人 (氏名又は名称)  
東レ株式会社

## 1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎  
 第II欄 優先権  
 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成  
 第IV欄 発明の單一性の欠如  
 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  
 第VI欄 ある種の引用文献  
 第VII欄 國際出願の不備  
 第VIII欄 國際出願に対する意見

## 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

## 3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

19.02.2004

名称及びあて先  
日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号 100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号特許庁審査官 (権限のある職員)  
長屋 陽二郎

3S 3324

電話番号 03-3581-1101 内線 3390

## 第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ  配列表  
 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット  書面  
 コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期  出願時の国際出願に含まれる  
 この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された  
 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3.  さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 指定意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 4-21	有
	請求の範囲 1-3	無
進歩性 (IS)	請求の範囲 1-21	有
	請求の範囲	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-21	有
	請求の範囲	無

## 2. 文献及び説明

- 文献1：JP 2001-351950 A (東レ株式会社),  
2001. 12. 21
- 文献2：JP 5-147819 A (イビデン株式会社), 1993. 06. 15
- 文献3：JP 2002-128388 A (シャープ株式会社),  
2002. 05. 09
- 文献4：JP 2002-282832 A (株式会社リコー),  
2002. 10. 02
- 文献5：JP 62-56245 A (ソマール株式会社), 1987. 3. 11
- 文献6：日本国実用新案登録出願50-8855号 (日本国実用新案登録出願公開  
51-90837号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影した  
マイクロフィルム (富士写真フィルム株式会社) (富士写真フィルム株式  
会社), 1976. 07. 21
- 文献7：JP 9-194128 A (松下電工株式会社), 1997. 07. 29
- 文献8：JP 2001-89018 A (日立テクノエンジニアリング株式会  
社), 2001. 04. 03

## 請求の範囲 1-3

請求の範囲1乃至3に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から  
新規性を有さない。請求の範囲1に記載された補強板、剥離可能な有機物層、回路  
パターンを備えた可撓性フィルム、剥離補助層が順に積層された回路基板用部材、  
請求の範囲2に記載された回路パターン上に接合された電子部品、及び請求の範囲  
3に記載されたソルダーレジストは、文献1の第9欄、第23行-第10欄、第29  
行に示されている。

## 請求の範囲 4-7, 9, 12, 14, 21

請求の範囲4乃至7, 9, 12及び21に記載された発明は、国際調査報告で引  
用された文献1および文献2より進歩性を有しない。文献1と2の発明は回路基板  
用部材から可撓性フィルムを剥離するという点で同一の技術課題を有する。文献1  
の発明において、その共通する技術課題を解決するために、文献2の第4欄、第3

**補充欄**

いずれかの欄の大きさが足りない場合

**第 V.2 欄の続き**

1行-第5欄, 第12行, 第6欄, 第33-45行及び図3に示されている、部材から可撓性フィルムを、剥離角を鋭角に保ちつつ、湾曲した支持体に沿わせて、可撓性フィルムの湾曲を進行させながら剥離する手段を適用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

**請求の範囲 8**

請求の範囲 8 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1 乃至文献 3 により進歩性を有さない。文献 3 の第 19 欄, 第 31-43 行には、回路基板用部材から可撓性フィルムを剥離する際の可撓性フィルムの曲率半径を、50 mmとした点が開示されており、引用文献 1 及び 2 の回路基板の製造方法において、上記記載に基づき、可撓性フィルムの支持体の曲率半径を限定することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

**請求項 10, 15, 16 について**

請求の範囲 10, 15 及び 16 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1, 2 及び 4 に対して進歩性を有さない。引用文献 4 の第 8 欄, 第 13-34 行には、支持体を回転させながら、被着体に対して相対運動させることにより、可撓性フィルムを剥離し、さらに支持体の可撓性フィルム支持面での回転周速度を支持体の被着体に対する相対移動速度よりも大きくし、可撓性フィルムに作用する張力を制御した点が記載されている

**請求項 11 について**

請求の範囲 11 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1, 2 及び 5 により進歩性を有さない。文献 1, 2 及び 5 の発明は回路基板用部材から可撓性フィルムを剥離するという点で同一の技術課題を有する。文献 1 及び 2 の発明において、その共通する技術課題を解決するために、引用文献 5 の第 4 頁, 右下欄, 第 8-9 行に記載の回路基板部材と可撓性フィルムとの間にくさび型の剥離部材を挿通する方法を用いることは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

**請求項 13, 20 について**

請求の範囲 13 及び 20 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1, 2 及び 6 により進歩性を有さない。文献 1, 2 及び 6 の発明は被着部材から可撓性フィルムを剥離するという点で同一の技術課題を有する。文献 1 及び 2 の発明において、その共通する技術課題を解決するために、引用文献 6 の第 3 頁, 第 10-13 行及び第 5 頁, 第 19 行-第 6 頁, 第 1 行に記載の、可撓性フィルムの剥離の際に加熱する方法を用いることは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

**請求項 17 について**

請求項 17 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1, 2 及び 7 により進歩性を有さない。文献 7 の第 4 欄, 第 24-28 行には、支持体が回路基板の凸

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

部に対応した凹部を有した点が開示されている。

請求項 18について

請求項 18に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1, 2 及び 8 により進歩性を有さない。文献 8 の第 4 欄、第 9—19 行には、支持体にタック性を有した層を設けた点が開示されている。

請求項 19について

請求項 19に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1, 2 及び 5 により進歩性を有さない。引用文献 5 の第 2 頁右下欄、第 16 行—第 3 頁、右上欄、第 14 行には、回路基板用部材の支持体と、くさび形の剥離部材を有する可撓性フィルムの剥離手段と、これら支持体と剥離手段とを相対的に移動させる移動手段を備え、剥離手段がくさび形の剥離部材の位置決め機構を備えた点が開示されている。